

スクリーン印刷用 導電性銅ナノペースト

Conductive Cu Nano Paste for Screen printing

特長 Features

- 1 純銅に近い低抵抗な銅皮膜が得られます。
The resistivity of Cu film is close to that of bulk copper.
- 2 PI、ガラス等の基板上で回路形成が可能です。
Minute Cu circuit patterns can be formed on polyimide(PI), and glass with the Cu nano paste.
- 3 スクリーン印刷法で厚膜の銅回路形成が可能です。
The Conductive Cu Nano paste can be printed patterns of thick Cu film circuit for screen printing.

ペースト特性 Properties of paste

型番	Applicable substrate	SC-03 (PI,glass etc.)
Cu濃度 (mass%)	Cu content	<85
平均粒径 (nm)	M.D.	<70
粘度 (Pa・s)	Viscosity	2.5 ± 1.0
体積抵抗率 (μΩ・cm)	Resistivity	<ul style="list-style-type: none"> ・6-8 (vs. PI and glass) キセノンフラッシュランプによる焼成 (<5μm厚) Sintering by Xenon flash lamp ・15-20 (vs. PI and glass) ギ酸リフロー、250°C、10min Vacuum reflow in formic acid atmosphere
密着性	Adhesion	テープ剥離無し (vs. PI and glass) No peeling vs. PI and glass

スクリーン印刷 Screen printing



PI上の銅回路と配線形状
Cu circuit pattern on PI and line profile
膜厚 Thickness of the film : 35μm
線幅 Line width : 1mm



35μm厚



焼成後の断面SEM像
Cross-sectional SEM image after Cu film
ギ酸リフロー焼成 (250°C,10min)
Vacuum reflow in formic acid atmosphere

本資料に記載する数値は当社の試験に基づく実測値であり、保証値ではありません。
We do not give any guarantee concerning technical values on this catalog.

